

留学生・留学経験者対象

陶板レリーフデザイン募集



この度、令和4年度に開館される国際交流棟（Hisao&Hiroko TAKI PLAZA）に設置するパブリックアートの一つとして、東京藝術大学で学んだ多くの留学生のデザインが陶板になり、階段ホールの壁面を飾ることとなりました。皆さんの作品が本校に何十年先も残る作品となります。
追加募集、第3回目の募集となる今回も、留学生および留学経験のある日本人の作品を募集いたします。多くの方のご参加をお待ちしております。

第1回目に応募いただいた陶板のデザインは12月中旬より国際交流棟にてご覧になれます。第2回目以降に提出された作品は令和5年度に取付けられる予定です。

* 卒業生、研究生、留学経験のある日本人学生も含めた、全ての留学生対象です。

【提出作品例】



デザイン提出
このように3層までのドローイングを提出していただきます。



粘土
提出していただいたデータを元にクレーン工房にて粘土を制作します。



素焼き状態
釉薬は施さず、焼き締めに夜土味を生かした土色の状態のものを展示します。

【作品提出はこちらから↓】



○作品提出期限：令和5年1月30日
○応募方法：google フォームに回答

エントリーフォームの記入が難しい場合は下記のアドレスにメールをお送りください。

メール件名：「留学生交流会館パブリックアート応募」
提出先：fujita.kurea@fa.geidai.ac.jp

国際交流拠点整備事業 パブリックアート『共に藝える』

留学生交流会館パブリックアート、陶板レリーフ制作者募集



募集内容：

- ・ 1枚 30cm²（応募方法に応じた厚みになります）
- ・ 3作品まで提出可能です

テーマ： 『藝える』

応募対象： 国籍、出身学科を問わず、東京藝術大学音楽学部、美術学部の留学生（現役生、卒業生、研究生）、留学経験のある方（現役生、卒業生）

デザイン提出期限：2023年1月30日〆切

お問い合わせ先：下記のリンクの google フォームよりお問い合わせください。

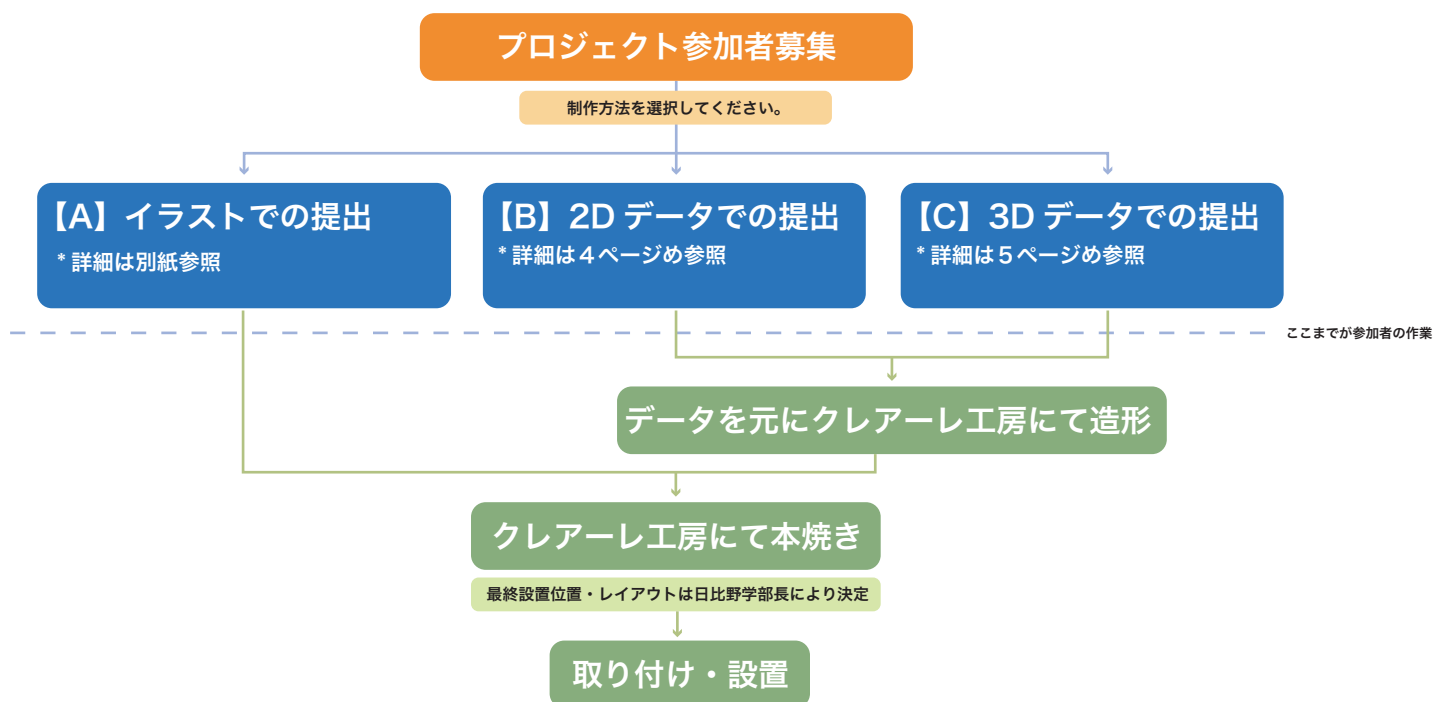
<https://forms.gle/AuRuqrYGNoqqFkW46>

[質問フォーム] フォーム記入が難しい方はメールにてご連絡ください。



fujita.kurea@fa.geidai.ac.jp

陶板レリーフ制作参加の流れ



粘土造形例



【B】 2D データでの提出

3 作品提出可能。

参加者が制作した原画（白黒画、線画）を 2D データで提出後、外部工房にて陶板職人が粘土を造形し、国際交流会館室内にて長期に渡って展示されます。

***階層の違いを明確に指示すること**

→仕上がりイメージのレイヤー順序を白黒濃淡や色で指示してください。

(例) 黒 = 凹、灰色 = 中、白 = 凸

*** 3層まで可（ベース（土台）を入れて3層になります）**

→ 1層の場合：仕上がり板厚 3cm、2層の場合：仕上がり板厚 4cm、

3層の場合：仕上がり板厚 5cm)

***細すぎる線は、型を取るときに崩れる場合がありますので、太くしてもらう事になるかもしれません。**

→3mm 以内の突き出た線は特に崩れやすくなります。

提出形式：ベクターデータ (EPS, ai.) での提出

*ベクターデータ提出が難しい場合は画像データ (jpeg, PNG) も可

提出期限：2023 年 1 月 30 日 10:00AM (JST)

2D データ用提出先：<https://forms.gle/aLYfUZZtJYV7WEuw5>

*フォルダー名には必ず、氏名と日付を記入ください。

フォームでの提出が難しい場合は大容量ファイル転送サービスにアップロードし、リンクをメールで送信してください。

[2D 提出フォルダー]

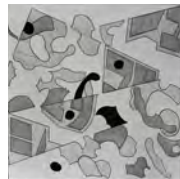


2D 提出の場合の作業工程

1 層



3 層 (層の違いは白黒濃淡や色で指示)

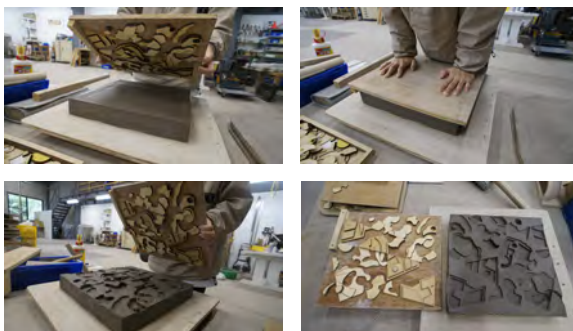


▼外部工房での作業工程

レーザーで型板を作成



型板を粘土に押し付ける



【C】 3D データでの提出

3 作品提出可能。

参加者は作品の 3D データ（工業系の CAD データ 拡張子は STL か IGES）を作成し、提出。

それをもとに外部工房で作成した雌型に陶芸粘土を型詰めし、作品を立体化する。

*3D データ提出の際は必ず画像データ（スクリーンショットでも可）も一緒に提出すること。

*スキャンデータを提出する場合は別途、作品実物を**正面および斜め上下左右から**
写した写真も添付

*抜け勾配（型詰めして抜ける形）であるかを考慮しなければいけない

*陶板厚み = 7cm、加工可能高さは 5cm（**ベース（土台）には 2cm は残してください。**）

*3層まで可（ベース（土台）を入れて3層になります）

提出形式：CAD データ（STL, IGES）での提出。

写真 / 画像データは (jpeg, PNG) でフォルダーに入れて提出。

提出期限：2023 年 1 月 30 日 10:00AM (JST)

3D データ用提出先：<https://forms.gle/aLYfUZZtJYV7WEuw5>

*フォルダー名には必ず、氏名と日付を記入ください。

フォームでの提出が難しい場合は大容量ファイル転送サービスにアップロードし、
リンクをメールで送信してください。

[3D 提出フォルダー]



(例)

ReCAPphoto を使用したスキャンデータ作成し、3D データでの提出も可

詳しくは AUTO DESK ReCAPphoto ウェブページを参照：

<https://www.autodesk.co.jp/products/recap/features>



参加者は各自で調達した素材（粘土など）で
レリーフ原型を制作



制作したレリーフ原型を ReCAPphoto でスキャンする。

ただしスキャンした 3D 原型は細部の再現が粗くなるため、

レリーフ原型を正面および斜め上下左右から写した画像が別途必要